

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2023-036

## 成都天箭科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知已于2023年10月24日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

##### 1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编码：2023-035）。

##### 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

董事会同意公司向中信银行股份有限公司成都高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行各申请综合授信额度人民币壹亿元（最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准），授信内容为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信期限为十二个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-038）。

本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日